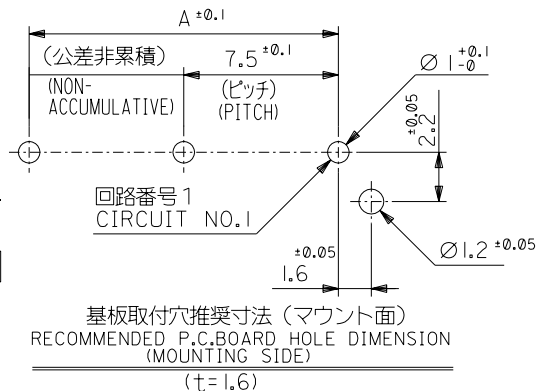
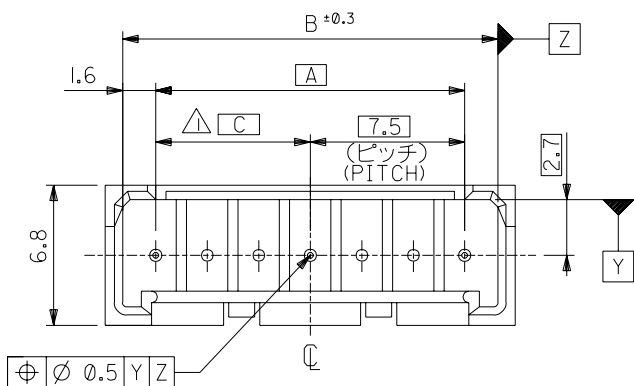


8 7 6 5 4 3 2 1

注記
NOTES

△ ウエハーの ϕ から隣接するピンの ϕ までの位置を示す。
SHOW POSITION FROM ϕ OF WAFER
TO ϕ OF ADJACENT PIN.

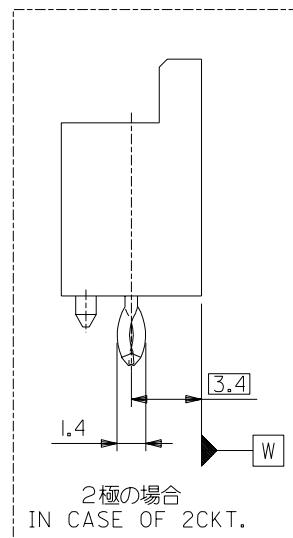
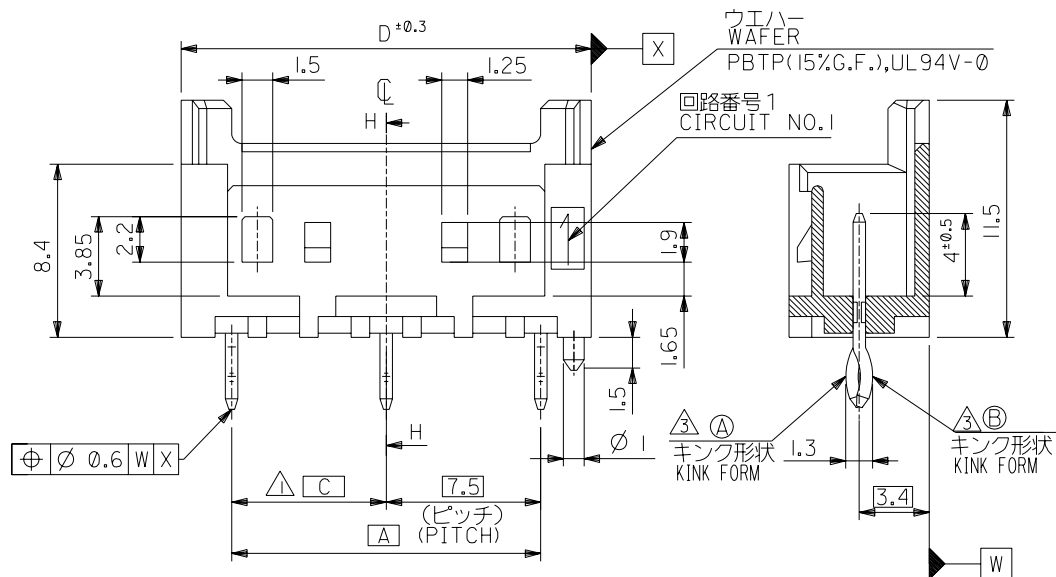
2. 嵌合相手: 51102, 51103 シリーズ
MATES WITH: 51102, 51103 SERIES.

△ 3極以上のキンク形状は両サイドが (A)、その他の極はすべて (B) 形状とする。

KINK FORM

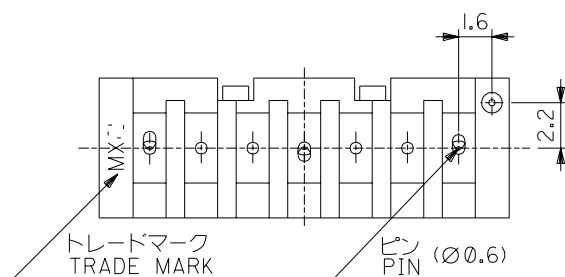
MORE THAN 2 CURCUIT:

PINS AT BOTH ENDS ARE KINK FORMED TO (A),
THE OTHER PINS ARE KINK FORMED TO (B).

断面 H-H
SECT. H-H2極
2 CKT.

ロック形状図

LOCK CONFIGURATION

2極の場合
IN CASE OF 2CKT.トレードマーク
TRADE MARK

ピン (0.6)

リン青銅、銅下地 錫メッキ
PHOSPHOR BRONZE, TIN OVER COPPER PLATING

材料 MATERIAL				図中参照 SEE DRAWING		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH				—#—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE				—#—		TITLE 名称 7.5 WIRE TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y WITH KINK -LEAD FREE-	
被覆外径 INS. RANGE				—#—		DRAWN BY '92/12/22 K.TOJO	
CHK'D BY '93/7/16 H.HIRAMOTO				尺 SCALE		4 : 1	
角 ANGLE				度 DEGREE		D DWG. NO.	
30°以上 OVER				+0.3		SD-53388-**-10	
10°以上 30°未満 UNDER				+0.25		REV C	
10°未満 UNDER				+0.2			
一般公差 GENERAL TOLERANCES				記号 LTR			
変更内容 REVISION RECORD				DR. CHK.			
角度 ANGLE				+3°			
30°以上 OVER				+0.3			
10°以上 30°未満 UNDER				+0.25			
10°未満 UNDER				+0.2			
新規格作成 RELEASED				J2004			
Y.W. M.S.				04/04/05			
K.T. H.H.				'93/7/16			
K.T. H.H.				'93/2/9			
K.T. H.H.				'92/12/22			
DR. CHK.				日付 DATE			
M.FUKUSHIMA							